

## 元續科技(8637)

開始認購日期	2024年6月21日
截止認購日期	2024年6月26日上午
公開發售結果	2024年6月28日
上市日期	2024年7月2日
保薦人	大華繼顯

### 集團概要:

公開發售價	\$2.38-3 元
市值	\$357-450 百萬港元
行業	半導體
全球發行股數	27,000,000
集資總額	\$81 百萬(HK\$3 計算)
香港發售股份佔比	10.0%
每手入場費	3,030.25 港元

### 集團簡介:

集團是一家總部設於新加坡的精密工程服務供應商，專門為半導體及其他界別的國際公司提供精密機加工及精密焊接服務。於 2023 年，集團在新加坡精密部件工程行業的半導體分部按收益計排名第五，市場佔有率約為 3.3%。集團為客戶提供精密工程服務，包括精密機加工服務及精密焊接服務。精密機加工涉及使用電腦數控機器及其他先進機器工具進行材料切割及成型，並生產在尺寸、形狀、表面光潔度及其他幾何屬性方面均符合極其嚴格的規格要求的微米級精度零件。

### 行業現況

全球精密工程行業的產出價值由 2019 年的 4,034 億坡元增加至 2023 年的 5,257 億坡元，複合年增長率為 6.8%，預料於 2028 年將增加至 6,465 億坡元，2023 年至 2028 年的複合年增長率為 4.2%。全球精密工程行業半導體分部於 2019 年至 2023 年錄得強勁增長，複合年增長率為 17.7%。由 2024 年第三季開始，受人工智能需求及電子產品及集成電路銷售急增帶動，全球半導體製造行業預期將恢復增長。

經國農證券認購截止日期

2024 年 6 月 25 日 3pm

經國農證券認購手續費

現金全數認購	一律\$0 手續費
孖展融資認購	\$100 手續費
融資借貸日數	1 日

### 行業風險

集團無法控制影響終端市場的因素。倘未來發生任何有關因素，導致集團的任何或所有主要終端市場嚴重放緩，或集團的終端市場的增長不能持續，集團的業務、財務狀況、經營業績及前景可能會受到重大不利影響。特別是，倘未來對半導體相關產品的需求因任何原因而減少，則對客戶 A 及半導體行業其他客戶的製造設備的需求可能會相應減少，從而可能會大大減少對集團精密部件工程服務的需求，並對集團的業務、經營業績及財務狀況產生重大不利影響。

### 主要財務數據:

(人民幣千元)	2022	2023
收入	39,116	38,769
銷售成本	(23,060)	(24,354)
毛利	16,056	14,415
除稅前溢利	5,295	3,345
淨溢利	2,705	4,427

集資用途	(百分比)
用於擴充營運規模及提升產能	60.1%
用於加強品質監控能力	15.4%
用作營運資金及一般企業用途	10%

### 主要股東

股東名稱	持股百分比(%)
SGP Capital Holdings Limited	39.1%
Baccini Capital Holdings Limited	16.5%